

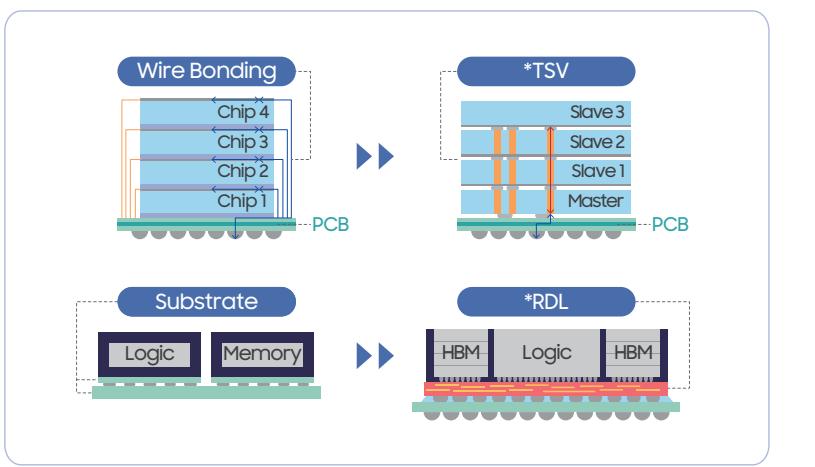
Advanced Package

Heterogeneous Integration 반도체 성능 향상을 위한 새로운 Solution

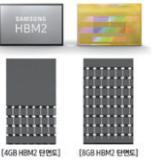
최첨단 기술을 활용하여 이종 Chip(Memory/Logic) 연결을 통해
하나의 Package에 고성능 System을 구현

반도체 Package Paradigm Shift

High Bandwidth/Low Power/Low Latency를 위한 새로운 형태의 Integration Solutions



Advanced Package 주요 개발 제품



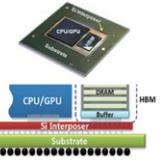
HBM(High Bandwidth Memory)

TSV기술을 적용한 그래픽 및 서버향 고 대역폭 Memory



FO-PLP/FO-WLP (Panel Level PKG/Wafer Level PKG)

FO-PLP/FO-WLP를 적용하여 AP, PMIC, Memory 등의 소자를
임베딩하고 Wearable 탑재 System-in-PKG 구현



2.5D Package

CPU/GPU 등 SLSI제품과 HBM Memory제품을 1개의 Package로
구현한 제품

RECRUITMENT | 채용전형|

신입채용



지원서 접수



직무적합성 평가



기술면접



GSAT
(SW역량테스트)



인성면접



종합면접



건강검진

경력채용



지원서 접수



기술면접



GSAT
(SW역량테스트)



인성면접



종합면접



건강검진

SAMSUNG

2024 상반기
삼성전자 DS부문
신입 채용

당신의 성장이
세상의 혁신으로
이어지는 곳
삼성전자 반도체

[나]를 찾습니다

기업이 바라는 인재가 되기 위해 나자신을 바꿔야 할까요?

우리는 '나다움'이 곧 남다름이란 것을 압니다. 당신만의 색깔로 더 멀리, 더 크게 채워나가도록
삼성전자 반도체가 함께하겠습니다.

삼성전자 DS부문 AVP사업팀

채용 온라인 지원

삼성전자 DS부문 채용

AVP사업팀 공식 채용 이메일주소

* 자세한 사업부/직무 관련 내용과 안내는 위 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.



AVP사업팀 Online 채용설명회 신청폼

AVP사업팀(AVP사업팀)

Advanced Package 플랫폼으로 반도체 미세 공정 한계를 돌파

Mission : 우리의 PKG 플랫폼을 세상의 모든 반도체에!

Vision : 반도체의 초연결로 세상을 훔들다

반도체 산업은 미세 공정의 한계에 점점 봉착하고 있으며, 이를 돌파하기 위해 최첨단 기술을 연구하고 제품을 개발/양산/Test하여 고성능 반도체 Package 솔루션을 제공합니다.

AI, Server, Data Center, Graphic, Wearable과 같이 고사양/최첨단 반도체를 요구하는 고객들에게 이종(Memory&Logic) Chip 간의 연결(Heterogeneous Integration)을 통해 하나님의 고성능 반도체 Package를 구현합니다.

미국과 일본에 연구소를 설립하여 선행기술 확보에 집중하고 있으며,
국내에서는 DS부문 각 사업부들과 연계하여 Advanced Package
제품(HBM/3D Package, 2.5D Package, FO-WLP/FO-PLP 등)을 개발/양산/Test하여
Global Semiconductor Packaging Center로 입지를 다지고 있습니다.

AVP사업팀 복지



선택적
근로시간제



출퇴근
통근버스 운행



사내
병원 및
건강 관리 센터



사내
휘트니스 센터



최고 수준의
식당



복리후생

국내 사업장



화성 캠퍼스

Business Development, Adv. PKG 설계 및 Simulation



천안 캠퍼스

HBM, 2.5D PKG 등 Adv. PKG 제품 및
기술 개발과 양산



KTX, SRT 모두 이용 가능

- KTX 소요시간 : 서울(43분), 용산(37분), 광명(24분)

- SRT 소요시간 : 수서(35분), 동탄(16분)

- 차도권(통근버스) : 천안마산역 → 천안캠퍼스(13분)

* 서울 지역에서 1시간 내외로 출/퇴근 가능

- 수도권 각지로 통근버스 운영

(서울/분당/수원/수원/동탄/병점/오산/대전/세종/청주 등)

AVP사업팀 전공별 직무/업무



기계공학

패키지개발	
제품개발/선행기술 연구	제품 개발 총괄 및 선행 기술 연구, 제품의 기계적/구조적 특성 분석
단위 공정 개발	Device 구조에 적합한 공정 개발 및 차세대 공정 Concept 연구
설계 및 시뮬레이션	설계 Tool을 사용하여 PCB/Substrate 및 Interposer 등 기구설계 Mechanical Simulation을 통한 Concept 검증 및 구현, Package Design 최적화
반도체공정기술	
양산공정 개선/생산성 향상	공정 조건 표준화, 분석Tool을 통한 불량률 개선/생산성 향상
공정 기반기술 연구	공정 품질 관리, 공정 최적화를 통한 공정 기술 효율 극대화
공정/설비 문제 분석	기계/설비 지식으로 공정/설비의 문제/Data 분석
평가및분석	
패키지 평가분석	기계적 분석을 통한 불량 원인 분석 및 개선
개발/양산 Qualification	공정 품질 관리, 공정 최적화를 통한 공정 기술 효율 극대화
수율 개선	제품 양산성 관리 및 수율 개선
설비기술	
반도체 설비 유지/보수	피로한도 및 응력을 고려한 설비, 부품 주기 관리
설비 개조/개선	설비의 기계적 특성에 따른 개조 및 시스템 개발
제조 인프라 개선	내구성, 위치를 고려한 신규 설비 Set up
영업마케팅	
영업/마케팅	응용처별, 거래선별 마케팅/영업 전략을 수립하여 수익 창출

수학/통계학

평가 및 분석	
품질&통계연구	통계 모델링을 적용하여 공정최적화 및 불량 원인 밸굴 Data Mining/분석으로 제품 특성 및 품질 예측
생산관리	
공급망 최적화	통계 모델링 기반 Data 분석으로 생산과정 최적화
S/W개발	
품질&통계연구	설비 운영, 공정최적화 및 불량원인 밸굴/분석 S/W 개발
영업마케팅	
영업/마케팅	응용처별, 거래선별 마케팅/영업 전략을 수립하여 수익 창출

컴퓨터공학/전산계열

생산관리	
생산 System 개발	물류 로직 개선, 운영 시스템 개선
SW개발	
설비 운영 S/W개발	설비 동작/Data 활용/UI 시스템 개발
Test/생산/품질 제어	Test/생산성 향상 알고리즘 개발
영업마케팅	
영업/마케팅	응용처별, 거래선별 마케팅/영업 전략을 수립하여 수익 창출



재료/금속

패키지개발	
제품개발/선행기술 연구	제품 개발 총괄 및 신공정 소재 개발, 제품의 불량 개선을 위한 소재 Concept 제안
단위 공정 개발	소재/공정 간 최적의 공정성 확보를 위해 평가 및 안정화, 차세대 공정 Concept 연구
소재 개발	공정의 품질/제품의 원가 경쟁력 확보 등을 위한 신규 소재 개발 및 연구
설계 및 시뮬레이션	Thermal Simulation을 통한 Concept 검증 및 구현, Package Design 최적화
반도체공정기술	
양산공정 개선/생산성 향상	소재 밸굴 및 품질 최적화를 통한 불량 개선/생산성 향상
공정 기반기술 연구	소재 품질 관리, 소재/화학 특성으로 공정 최적화/효율극대화
공정/설비 문제 분석	소재/화학 지식으로 공정/설비의 문제/Data 분석
평가및분석	
패키지 평가분석	SEM, TEM 분석을 통한 불량 원인 분석 및 개선
개발/양산 Qualification	개발/양산 단계 품질 신뢰성 검증
수율 개선	제품 양산성 관리 및 수율 개선
설비기술	
반도체 설비 유지/보수	재료의 물성, 화학적 특성을 고려한 설비, 부품 주기 관리
설비 개조/개선	설비의 물성을 고려한 설비 개조/개선
제조 인프라 개선	내구성, 위치를 고려한 신규 설비 Set up
영업마케팅	
영업/마케팅	응용처별, 거래선별 마케팅/영업 전략을 수립하여 수익 창출



화공/화학

패키지개발	
제품개발/선행기술 연구	제품 개발 총괄 및 신공정 소재 개발, 제품의 불량 개선을 위한 소재 Concept 제안
단위 공정 개발	소재/공정 간 최적의 공정성 확보를 위해 평가 및 안정화, 차세대 공정 Concept 연구
소재 개발	공정의 품질/제품의 원가 경쟁력 확보 등을 위한 신규 소재 개발 및 연구
설계 및 시뮬레이션	Thermal Simulation을 통한 Concept 검증 및 구현, Package Design 최적화
반도체공정기술	
양산공정 개선/생산성 향상	소재 밸굴 및 품질 최적화를 통한 불량 개선/생산성 향상
공정 기반기술 연구	소재 품질 관리, 소재/화학 특성으로 공정 최적화/효율극대화
공정/설비 문제 분석	소재/화학 지식으로 공정/설비의 문제/Data 분석
평가및분석	
패키지 평가분석	SEM, TEM 분석을 통한 불량 원인 분석 및 개선
개발/양산 Qualification	개발/양산 단계 품질 신뢰성 검증
수율 개선	제품 양산성 관리 및 수율 개선
설비기술	
반도체 설비 유지/보수	재료의 물성, 화학적 특성을 고려한 설비, 부품 주기 관리
설비 개조/개선	설비의 물성을 고려한 설비 개조/개선
제조 인프라 개선	내구성, 위치를 고려한 신규 설비 Set up
영업마케팅	
영업/마케팅	응용처별, 거래선별 마케팅/영업 전략을 수립하여 수익 창출



전기/전자

패키지개발	
제품개발/선행기술 연구	제품 개발 총괄 및 신공정 소재 개발, 전기적 특성 분석
단위 공정 개발	Device 구조에 적합한 공정 개발 및 차세대 공정 Concept 연구
설계 및 시뮬레이션	설계 Tool을 사용하여 PCB/Substrate 및 Interposer 등 회로설계 Electrical Simulation을 통한 Concept 검증 및 구현, Package Design 최적화
반도체공정기술	
양산공정 개선/생산성 향상	소재/공정 간 최적의 공정성 확보를 위해 평가 및 안정화, 차세대 공정 Concept 연구
공정 기반기술 연구	설계 Tool을 사용하여 PCB/Substrate 및 Interposer 등 회로설계 Electrical Simulation을 통한 Concept 검증 및 구현, Package Design 최적화
공정/설비 문제 분석	Electrical Simulation을 통한 Concept 검증 및 구현, Package Design 최적화
평가및분석	
패키지 평가분석	전기적 특성을 바탕으로 공정 이슈 분석, 불량 개선/생산성 향상
개발/양산 Qualification	공정 품질 관리, 공정 최적화를 통한 공정 기술 효율 극대화
수율 개선	전자/전기 지식으로 공정/설비의 문제/Data 분석
설비기술	
반도체 설비 유지/보수	전자/전기 특성을 바탕으로 공정 이슈 분석, 불량 개선/생산성 향상
설비 개조/개선	설계 Tool을 사용하여 PCB/Substrate 및 Interposer 등 회로설계 Electrical Simulation을 통한 Concept 검증 및 구현, Package Design 최적화
제조 인프라 개선	전자/전기 지식으로 공정/설비의 문제/Data 분석
영업마케팅	
영업/마케팅	응용처별, 거래선별 마케팅/영업 전략을 수립하여 수익 창출



물리학

패키지개발	
제품개발/선행기술 연구	제품 개발 총괄 및 신공정 소재 개발, 재료의 전기적 특성 분석
단위 공정 개발	Backside 패턴 형성을 위한 CVD, Etch 공정 연구
설계 및 시뮬레이션	물리학적 원리 기반으로 Package Design 설계 물리학적 Simulation을 통한 Concept 검증 및 구현, Package Design 최적화
반도체공정기술	
양산공정 개선/생산성 향상	물리 지식 기반으로 공정 이슈 분석, 불량 개선/생산성 향상
공정 기반기술 연구	공정 품질 관리, 공정 최적화를 통한 공정 기술 효율 극대화
공정/설비 문제 분석	광학적 지식 기반으로 분석 시스템 개선 및 최적화
평가및분석	
패키지 평가분석	물리학적 지식을 활용한 불량 검출 및 원인 분석
개발/양산 Qualification	변동성과 불규칙성 분석 및 예측
수율 개선	제품 양산성 관리 및 수율 개선
설비기술	
반도체 설비 유지/보수	물리학적 이해를 바탕으로한 설비 유지/보수
설비 개조/개선	물리학적 모델링을 통한 설비 개조/개선
제조 인프라 개선	내구성, 위치를 고려한 신규 설비 Set up
영업마케팅	
영업/마케팅	응용처별, 거래선별 마케팅/영업 전략을 수립하여 수익 창출



AVP사업팀 직무별 전공

직무	관련전공
평가 및 분석	전기/전자, 재료/금속, 화학/화공, 기계공학, 물리학, 산업공학, 수학, 통계, 이공기타
반도체공정기술	전기/전자, 재료/금속, 화학/화공, 기계공학, 물리학, 이공기타
패키지개발	전기/전자, 재료/금속, 화학/화공, 기계공학, 물리학, 이공기타
설비기술	전기/전자, 재료/금속, 화학/화공, 기계공학, 물리학, 이공기타
생산관리	전산/컴퓨터, 산업공학, 수학, 통계, 이공기타
S/W개발	전기/전자, 전산/컴퓨터, 기계공학, 물리학, 산업공학, 수학, 통계, 이공기타
영업마케팅	전공무관

AVP사업팀 업무 Process

